

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2026-013

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称“苏州博创”）、无锡安趋电子有限公司（以下简称“无锡安趋”）、深圳芯朋电子有限公司（以下简称“深圳芯朋”）	35,000.00 万元	5,960 万元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	11,051.99
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.05

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

## 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

### （一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司苏州博创、无锡安趋和深圳芯朋就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 3.50 亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

被担保方	提供担保额度（亿元）
苏州博创	2
无锡安趋	1
深圳芯朋	0.50
合计	3.50

上述担保额度可以在公司全资子公司和全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2026 年度股东大会召开之日止。

## （二）内部决策程序

公司于2026年3月12日召开的第五届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司苏州博创、无锡安趋和深圳芯朋申请银行授信提供不超过人民币3.5亿元的担保额度。本议案无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）苏州博创集成电路设计有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	苏州博创集成电路设计有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	芯朋微持股 100%		
法定代表人	易扬波		
统一社会信用代码	91320594673014968T		
成立时间	2008-03-14		
注册地	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 89 号独墅湖数字经济产业园 7 幢 1801 室		
注册资本	6,000 万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	研发、销售：半导体集成电路及半导体分立器件、电子产品、计算机软硬件；销售：仪器仪表、普通机械、电器机械、五金交电；提供相关技术服务；从事上述商品和相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月(经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	489,656,240.89	450,127,292.06
	负债总额	123,116,264.79	121,498,556.56
	资产净额	366,539,976.10	328,628,735.50
	营业收入	413,026,865.85	217,520,476.33
	净利润	36,989,487.14	8,616,459.63

(二) 无锡安趋电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	无锡安趋电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	芯朋微持股 100%		
法定代表人	张立新		
统一社会信用代码	91320214MA1Q1YP93G		
成立时间	2017-08-08		
注册地	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 10 楼		
注册资本	500 万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	集成电路、半导体分立器件的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的开发、销售；仪器仪表、普通机械及设备、电器机械、五金产品的销售；技术服务；自营代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标 (元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月(经 审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	111,126,907.73	91,296,042.74
	负债总额	24,932,434.59	17,400,560.44
	资产净额	86,194,473.14	73,895,482.30
	营业收入	100,093,375.76	108,550,478.21
	净利润	12,093,230.81	14,437,033.24

(三) 深圳芯朋电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	深圳芯朋电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	芯朋微持股 100%		
法定代表人	薛伟明		
统一社会信用代码	91440300591886367T		
成立时间	2012-03-12		
注册地	深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦 1008		
注册资本	100 万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	机电产品的设计、开发与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月(经 审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	31,236,314.34	51,389,878.49
	负债总额	18,060,107.09	35,138,675.51
	资产净额	13,176,207.25	16,251,202.98
	营业收入	126,364,410.20	148,802,216.10
	净利润	-1,486,228.31	10,078,788.21

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

被担保人为公司全资子公司，融资是为满足其生产经营流动资金需要，上述担保事项是公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度提供的预计担保。本次公司对子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的持续发展。

### 五、董事会意见

公司于2026年3月12日召开的第五届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保，并同意授权公司管理层代表公司签署相关的所有合同、协议等有关法律文件。董事会认为：公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是基于对全资子公司业务情况的预计，符合公司及全资子公司生产经营的需要，是为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司对外担保总额为11,051.99万元，为公司对全资子公司的担保及全资子公司对全资子公司员工租房的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的3.34%和4.05%。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026年3月14日